

ICS 31.200
L 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 8976—1996
IEC 748-20—1988
QC 763000

膜集成电路和混合膜集成电路总规范

Generic specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits

1996-07-09 发布

1997-01-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 范围、目的和分类	1
1.1 范围	1
1.2 目的	1
1.3 F&HFICs 的技术分类	1
2 总则	2
2.1 优先顺序	2
2.2 有关文件	2
2.3 单位和符号	3
2.4 术语	3
2.5 标准值和优先值	6
2.6 标志	6
3 质量评定程序	6
3.1 制造的初始阶段	6
3.2 制造工序和转包	6
3.3 制造厂的批准	6
3.4 膜集成电路和混合膜集成电路的批准	7
3.5 鉴定批准	7
3.6 能力批准	8
3.7 放行批合格记录	10
3.8 延迟交货	10
3.9 经受破坏性或非破坏性试验的 F&HFICs 的交货	11
3.10 交货的补充程序	11
3.11 补充内容	11
4 试验和测量程序	11
4.1 总则	11
4.2 试验的标准条件	11
4.3 目检	13
4.4 电测量程序	13
4.5 环境试验程序	15

中华人民共和国国家标准

膜集成电路和混合膜集成电路总规范

Generic specification for film integrated
circuits and hybrid film integrated circuits

GB/T 8976—1996

IEC 748-20—1988

QC 763000

代替 GB 8976—88

本规范等效采用国际标准 IEC 748-20/QC763000(1988)《膜集成电路和混合膜集成电路总规范》。

1 范围、目的和分类

1.1 范围

本总规范适用于膜集成电路和混合膜集成电路(F&HFICs),包括 GB/T 16464—1996 第 IV 章第 2.4 条中的无源和有源的 F&HFICs。

本规范适用于供用户继续加工的半成品 F&HFICs,也适用于装有一个以上芯片的片式载体电路,而且这些芯片应作为分立的单元用膜互连技术互连起来。

本规范不包括印制电路板,但适用于包括印制电路板的 F&HFICs。

1.2 目的

本规范规定了质量评定程序以及电气、气候、机械和耐久性试验方法。

本规范概述了使用鉴定批准程序或能力批准程序时对产品放行提出的要求。这些程序的要求分别在 3.5 条和 3.6 条中给出。

1.3 F&HFICs 的技术分类

F&HFICs 按其结构和制造工艺分类如表 1。

表 1

膜	1) 厚膜 2) 薄膜 3) 其他
电路结构	1) 无源薄膜电路和无源厚膜电路 2) 有源薄膜电路和有源厚膜电路 3) 混合膜集成电路 4) 多基片组合
外贴元件	0) 无 1) 各种类型的无源元件和(或)已封装的有源器件 2) 各种类型的无源元件和有源器件,包括未封装的半导体芯片
电路封装	1) 无 2) 灌封 3) 有机材料空封 4) 无机材料空封